



shaping tomorrow with you

通富微电子150mil SOP8パッケージの 南通工場から合肥工場へ移管について

2020年12月
富士通セミコンダクターメモリソリューション株式会社

■対象製品：

通富微電子(南通工場)で製造中のSOP8(150milサイズ)品

■移管内容：

SOP8の組立/最終試験を南通工場から合肥工場へ移管します

■変更理由

現行、後工程を委託している通富微電子の南通工場のSOP8
ライン縮小に伴い同社の合肥工場への移管し製造を継続します

■全体スケジュール(次項参照)

■MB85RC16PNF-G-JNE1/JNERE1, MB85RC64PNF-G-
JNE1/JNERE1については組立ライン1ラインに縮小し2021年12月
まで維持します

■その他は2021年2月以降、順次合肥へ移管します

変更概要

■ 変更概要

項目	現行品（南通工場）	代替品（合肥工場）
後工程製造委託先	南通通富微電子(南通工場)	合肥通富微電子(合肥工場)
製品型格	変更ありません	
パッケージ外形	変更ありません	
リードフレーム	材質変更ありません。 インナーパターンが変わります	
Mold樹脂	MB85RS64TPNF-G-JNE2/JNERE2 MB85RS64TUPNF-G-JNE2/JNERE2	変更ありません
	上記以外の製品	変更(ハロゲンフリー対応)
ダイ付材料	MB85RC512TPNF-G-JNE1/JNERE1 MB85RC1MTPNF-G-JNE1/JNERE1 MB85RS512TPNF-G-JNE1/JNERE1 MB85RS1MTPNF-G-JNE1/JNERE1	変更(Agペースト)
	上記以外の製品	変更ありません(Agペースト)
リード外装めっき	MB85RS64TPNF-G-JNE2/JNERE2 MB85RS64TUPNF-G-JNE2/JNERE2	変更ありません(Snめっき)
	上記以外の製品：Sn-Biめっき	変更(Snめっき)
製品外観	変更ありません	
MSL	JEDEC MSL Level3での対応は変更ありません	

参考：通富微电子 HFTF合肥工場

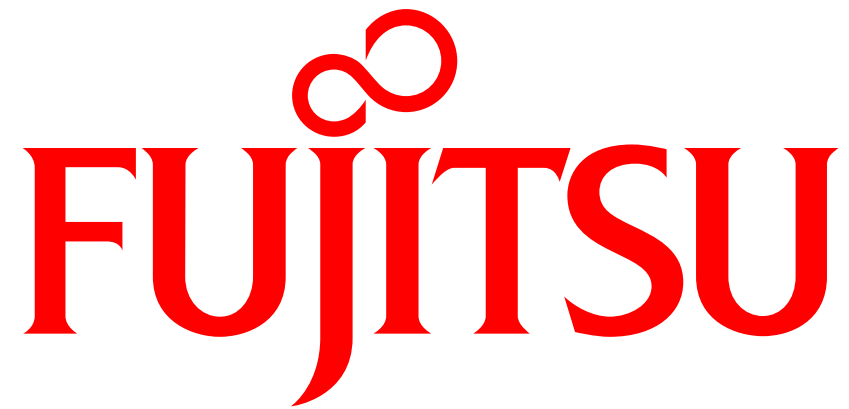
FUJITSU



安徽省合肥市经济开发区卫星路578号

1,400,000sq.ft.





shaping tomorrow with you